

2023年11月2日

各位

会社名 ミネベアミツミ株式会社

代表者名 代表取締役 会長 CEO

貝沼 由久

(コード番号 6479 東証プライム)

問合せ先 広報・IR室長

小峯 康生

(TEL 03-6758-6703)

株式会社日立パワーデバイスの株式取得（子会社化）及び事業譲受に関するお知らせ

ミネベアミツミ株式会社（以下、「当社」）は、株式会社日立製作所（以下、「日立製作所」）から、株式会社日立パワーデバイス（以下、「日立パワーデバイス」）の株式を取得（以下、「本株式取得」）し子会社化すること及び日立製作所グループのパワーデバイス事業に関する海外販売事業を譲り受けること（以下、「本事業譲受」）を決定し、本日付で日立製作所と株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得及び事業譲受の理由

当社は、超精密加工技術や大量生産技術等の当社の強みを発揮でき、且つ簡単に無くならない製品をコア事業「8本槍」として位置付けると共に、これらを相合*1（そうごう＝相い合わせる）することにより新たな価値をお客様に提供していくことを基本戦略としております。パワー半導体も手掛ける当社のアナログ半導体事業はこの8本槍の一つであり、リチウムイオン電池保護IC、電源IC、タイマーIC、MEMS*2センサー、磁気センサー、車載用メモリー等のみならず、IGBT*3をはじめとするパワー半導体領域においても更なる事業拡大を志向し、売上高800億円規模から2030年度にはM&Aも含めて3,000億円への成長を目標とし、一層の事業規模の拡大と事業価値の向上を目指しております。

日立パワーデバイスは、産業や社会インフラの電化・電動化におけるキー・デバイスであるパワー半導体製品を提供している半導体メーカーです。高度な基礎技術資産とモジュール化技術を基礎とした小型化と高性能化を両立した価格競争力のある製品を数多く生み出し、高い競争力を有した製品ポートフォリオを実現することで、高成長が見込まれるエンドマーケットにおいて確固たるポジションを確立しており、特に、高耐圧SiC、高耐圧IGBT、EV向けSG(サイドゲート)-IGBT、高圧IC、オルタネータ用ダイオード等のパワー半導体においては、豊富な技術開発力を背景として、優位性の高い技術・製品を有しています。

上記のとおり、当社ではIGBTビジネスの拡大を計画、推進してまいりましたが、チップビジネスの展開に留まり、当社としてモジュール化技術は有しておりませんでした。当社は、本株式取得及び本事業譲受により、従来のチップ製造に加え、パッケージ及びモジュールの後工程技術および生産能力を取得でき、「パワー半導体を開発から一貫生産できる垂直統合型のビジネス展開」が可能となります。さらに、統合による技術陣容の強化に加え、日立パワーデバイスの誇るSG-IGBTを含むユニークな技術と当社のチップ製造技術の相合により、SiパワーデバイスにおいてもSiCに近い性能を実現することや、日立パワーデバイスのSiC技術者集団が持つ高耐圧SiC技術を活かしたSiCパワーデバイス事業の発展など、パワーデバイス事業と既存当社内事業のシナジー効果を発現させ、パ

ワー半導体市場をリードできる競争力のある企業への躍進を図ります。従前より当社は日立パワーデバイスの前工程 Fab として製造受託しており、さらに、SG-IGBT は既に当社滋賀工場で試作中でありますので、垂直統合で統合初日より付加価値を取り込めるものと考えております。

パワー半導体は、EV に留まらず、GX（グリーントランスフォーメーション）、風力・太陽光等の再生可能エネルギー、電力・パワーグリッド、電鉄等の大型輸送機器、データセンター、重粒子線治療や MRI 等の医療・ヘルスケア、産業機器・工作機器等での需要が高まっているものと理解しております。マスの市場に加え、尖った強みを活かしやすいニッチな市場で強みを発揮させることで、大きなシナジー効果を生み出し、アナログ半導体事業として 3,000 億円をさらに上回る成長を目指してまいります。

*1 相合：「総合」ではなく、「相い合わせる」ことを意味し、自社保有技術を融合、活用して「コア製品」を進化させるとともに、その進化した製品をさらに相合することでさまざまな分野で新たな製品を創出すること。

*2 Micro Electro Mechanical Systems

*3 パワー半導体素子の一つである絶縁ゲートバイポーラトランジスタ

2. 異動する子会社の概要

(2023 年 11 月 2 日現在)

(1) 名称	株式会社日立パワーデバイス	
(2) 所在地	茨城県日立市大みか町五丁目 2 番 2 号	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 鈴木 雅彦	
(4) 事業内容	半導体部品の設計、製造及び販売 半導体応用機器と部品の設計、製造及び販売	
(5) 資本金	450 百万円	
(6) 設立年月日	2013 年 10 月 1 日	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社日立製作所 100.0%	
(8) 当社グループと当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社グループと当該会社の間には、製品に関する取引があります。
(9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態	当事者間の守秘義務により非公開としております。	

3. 譲受事業の概要

(1) 譲受事業の内容	パワーデバイス事業に関する海外販売事業
(2) 譲受事業の経営成績	当事者間の守秘義務により非公開としております。
(3) 譲受対象事業の資産・負債	事業譲渡日におけるパワーデバイス事業に関する海外販売事業に係る売上債権、商品在庫およびその円滑な承継のために必要な資産、負債として別途両当事者間で合意する資産、負債を譲り受けます。

4. 株式取得及び事業譲受の相手先の概要

(1) 名称	株式会社日立製作所
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号

(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長兼CEO 小島 啓二	
(4) 事業内容	デジタルシステム&サービス、グリーンエネルギー&モビリティ、コネクティブインダストリーズ等に係る製品の開発・生産・販売およびサービスの提供	
(5) 資本金	462,817 百万円 (2023 年 3 月期)	
(6) 設立年月日	1920 年 2 月 1 日	
(7) 純資産	5,335,567 百万円 (2023 年 3 月期)	
(8) 総資産	12,501,414 百万円 (2023 年 3 月期)	
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 3 月末時点)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	18.20%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	6.67%
	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	2.64%
	GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク, エヌ・エイ)	2.62%
	日本生命保険相互会社	2.13%
	日立グループ社員持株会	2.10%
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行)	2.09%
	ナッツ クムコ (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.85%
	ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティ 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.83%
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.57%	
(10) 当社グループと当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	当社グループと当該会社の間には製品に関する取引があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	450,000 株 (議決権の数：450,000 個)
(3) 取得価額	当事者間の守秘義務により非公開としております。
(4) 異動後の所有株式数	450,000 株 (議決権の数：450,000 個) (議決権所有割合：100.0%)

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2023 年 11 月 2 日
(2) 株式譲渡契約締結日	2023 年 11 月 2 日

(3) 本株式取得の実行日 (注)	現時点では本株式取得の実行日時期は未定ですが、早期の実行を目指してまいります。
----------------------	---

(注) 公正取引委員会等関係当局への届出(外国法に基づくものを含みます。)や許認可取得状況等によっては、本株式取得及び本事業譲受の実行日が変更となる可能性があります。

7. 今後の見通し

本件に伴う2024年3月期の当社の連結業績に与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が発生した場合には、判明次第速やかに開示いたします。

以上